



Spartan-3AN FPGA デバイスの フラッシュメモリ ウェハ製造工 場の変更およびパッケージワイヤ の金 (Au) から銅 (Cu) への変更

XCN14003 (v1.3) 2014 年 10 月 27 日

製品変更通知

概要

この通知は、Spartan®-3AN FPGA で使用されるインシステムフラッシュメモリのウェハ製造工場の変更およびプロセステクノロジーシユリンク (non-optical : 0.13um から 0.11um) を行うことのお知らせするものです。さらに、ワイヤボンダパッケージでの業界動向を反映し、金 (Au) ワイヤから銅 (Cu) ワイヤへ変更します。

説明

ザイリンクスは、Spartan-3AN FPGA デバイスのインシステムフラッシュメモリのウェハ製造工場を X-FAB (0.13um プロセス) から UMC (0.11um プロセス) へ変更します。ザイリンクスは、0.11um プロセスで製造されたインシステムフラッシュメモリを含む Spartan-3AN FPGA デバイスの品質評価および特性評価を実施しています。この変更によるフォーム、形状、機能への影響はありません。プログラミングアルゴリズムの変更については、[ザイリンクスアンサー 59572](#) を参照してください。

現在の業界動向やザイリンクスの製品ライン戦略を踏まえ、Spartan-3AN FPGA ファミリのワイヤが金 (Au) から銅 (Cu) へ変更になります。この変更によるワイヤボンダパッケージの形状、フォーム、機能、または MSL レートへの影響はありません。また、2011 年 8 月以降、Spartan®-3/-3E/-3A 製品の実装には銅ワイヤを使用している実績もあります。[XCN11002](#) を参照してください。Cu ワイヤのアセンブリには、ハロゲンフリーかつ EU-ROHS 準拠のパッケージとグリーンモールドコンパウンドのみを使用します。このパッケージには REACH 規制の SvHC 物質は含まれていません。

該当製品

この変更は、コマーシャル (C) およびインダストリアル (I) グレードデバイスの全スピードグレード、パッケージ、温度範囲の製品に該当します。オートモーティブ (XA) および高信頼性 (XQ) デバイスへの影響はありません。[表 1](#) に、該当製品番号を示します。

表 1: 該当する Spartan-3AN FPGA デバイス/パッケージ

デバイス	パッケージ
XC3S50AN ⁽²⁾	TQ(G)144
XC3S200AN	FT(G)256
XC3S400AN	FT(G)256
	FG(G)400
XC3S700AN	FG(G)484
XC3S1400AN ⁽²⁾	FG(G)676

注記:

1. プログラミングアルゴリズムの変更については、[ザイリンクスアンサー 59572](#) を参照してください。
2. XC3S50AN および XC3S1400AN デバイスの一部の製品は製造中止となっています。[XCN13016](#) を参照してください。
XCN13016 に該当する製品への、この製品変更通知による影響はありません。

© Copyright 2014 Xilinx, Inc. Xilinx, the Xilinx logo, Artix, ISE, Kintex, Spartan, Virtex, Vivado, Zynq, and other designated brands included herein are trademarks of Xilinx in the United States and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

表 2: 該当する Spartan-3AN FPGA ファミリー製品

製品番号	製品番号	製品番号	製品番号
XC3S50AN-4TQ144C4100	XC3S200AN-5FT256C	XC3S400AN-5FGG400C	XC3S1400AN-4FG676I
XC3S50AN-4TQ144I4100	XC3S200AN-5FTG256C	XC3S400AN-5FT256C	XC3S1400AN-4FG676I4301
XC3S50AN-4TQG144C	XC3S400AN-4FG400C	XC3S400AN-5FTG256C	XC3S1400AN-4FGG676C
XC3S50AN-4TQG144I	XC3S400AN-4FG400I	XC3S700AN-4FG484C	XC3S1400AN-4FGG676C4301
XC3S50AN-5TQG144C	XC3S400AN-4FGG400C	XC3S700AN-4FG484I	XC3S1400AN-4FGG676I
XC3S200AN-4FT256C	XC3S400AN-4FGG400I	XC3S700AN-4FGG484C	XC3S1400AN-4FGG676I4301
XC3S200AN-4FT256I	XC3S400AN-4FT256C	XC3S700AN-4FGG484I	XC3S1400AN-5FG676C
XC3S200AN-4FTG256C	XC3S400AN-4FT256I	XC3S700AN-5FG484C	XC3S1400AN-5FG676C4301
XC3S200AN-4FTG256C0862	XC3S400AN-4FTG256C	XC3S700AN-5FGG484C	XC3S1400AN-5FGG676C
XC3S200AN-4FTG256I	XC3S400AN-4FTG256I	XC3S1400AN-4FG676C	XC3S1400AN-5FGG676C4301
XC3S200AN-4FTG256I0913	XC3S400AN-5FG400C	XC3S1400AN-4FG676C4301	

キーデートおよび混在出荷情報

現在および今後の製品は、FAQ (XTP343) の表 1 に記載のスケジュールで混在出荷を開始する予定です。日付は、お客様からの需要などによって変更する可能性があります。

品質評価データ

品質評価データは、要望に応じて入手可能です。

お問い合わせ

この通知に対する回答は必要ありません。その他ご不明な点、ご質問等ございましたら、[ザイリンクス テクニカル サポート](#)までお問い合わせください。

重要なお知らせ : ザイリンクス カスタマー通知 (XCN、XDN、Quality Alert) リリースのお知らせは、ザイリンクスのサポートウェブサイト (<http://japan.xilinx.com/support>) から e-mail で受け取ることができます。アカウントご登録後、資料とデザイン アドバイザリ アラートにカスタマー変更通知が含まれるようにカスタマイズしてください。ザイリンクス サポート サイトでは、指定された製品に関する新規および更新情報、データシートやエラッタ、アプリケーション ノートなどに関するアラートを受け取ることができるサービスを提供しています。登録方法は、ザイリンクス アンサー 18683 を参照してください。
<http://japan.xilinx.com/support/answers/18683.htm>

その他の資料

XTP343 - FAQ : XCN14003 の補足
<https://secure.xilinx.com/webreg/clickthrough.do?cid=370908>

改訂履歴

次の表に、この文書の改訂履歴を示します。

日付	バージョン	内容
2014年5月5日	1.0	初版
2014年5月26日	1.1	(ページ 1) XC3S700AN(プログラミング アルゴリズム変更の影響を受ける)を追加
2014年10月6日	1.2	すべての該当デバイスについてプログラミング アルゴリズムが変更されたため、ザイリンクス アンサー 59572 の参照に関する記載を更新。
2014年10月27日	1.3	キーデートおよび混在出荷情報を更新。参考資料に FAQ (XTP343) を追加。

Notice of Disclaimer

The information disclosed to you hereunder (the "Materials") is provided solely for the selection and use of Xilinx products. To the maximum extent permitted by applicable law: (1) Materials are made available "AS IS" and with all faults, Xilinx hereby DISCLAIMS ALL WARRANTIES AND CONDITIONS, EXPRESS, IMPLIED, OR STATUTORY, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NON-INFRINGEMENT, OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE; and (2) Xilinx shall not be liable (whether in contract or tort, including negligence, or under any other theory of liability) for any loss or damage of any kind or nature related to, arising under, or in connection with, the Materials (including your use of the Materials), including for any direct, indirect, special, incidental, or consequential loss or damage (including loss of data, profits, goodwill, or any type of loss or damage suffered as a result of any action brought by a third party) even if such damage or loss was reasonably foreseeable or Xilinx had been advised of the possibility of the same. Xilinx assumes no obligation to correct any errors contained in the Materials or to notify you of updates to the Materials or to product specifications. You may not reproduce, modify, distribute, or publicly display the Materials without prior written consent. Certain products are subject to the terms and conditions of Xilinx's limited warranty, please refer to Xilinx's Terms of Sale which can be viewed at <http://www.xilinx.com/legal.htm#tos>; IP cores may be subject to warranty and support terms contained in a license issued to you by Xilinx. Xilinx products are not designed or intended to be fail-safe or for use in any application requiring fail-safe performance; you assume sole risk and liability for use of Xilinx products in such critical applications, please refer to Xilinx's Terms of Sale which can be viewed at <http://www.xilinx.com/legal.htm#tos>.

この通知は参照用として、英語版 (XCN14003、バージョン 1.3、2014 年 10 月 27 日リリース) を翻訳したものです。